证券代码：688757　　证券简称：胜科纳米　　编号：2026-005

胜科纳米（苏州）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐特定对象调研　　☐分析师会议 ☐媒体采访　　☑业绩说明会 ☐新闻发布会　　☐路演活动 ☐现场参观　　☐电话会议 ☐其他　（请文字说明其他活动内容）
参与单位	线上参与公司 2026 年第三季度业绩说明会的全体投资者
时间	2026 年 11 月 2 日　15:00-16:00
地点	价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动
上市公司接待人员姓名	1. 董事长兼总经理：李晓旻 2. 董事会秘书：周秋月 3. 财务负责人：洪凯 4. 独立董事：张毅
投资者关系活动主要内容介绍	**1、公司 iWUDI 智能闭环系统商业化进展怎样？** 答：根据公司披露的 2026 年第三季度报告，公司自主研发的搭载半导体全产业链垂直物理大模型 ChipMind 的 iWUDI 智能闭环系统，自 2026 年 6 月正式发布后的首个季度即第三季度实现了商业化销售订单的签署，含税订单金额合计为 79.57 万元，包括 C 端用户和 B 端企业级用户，其中企业级的用户包含日立，这标志着 iWUDI 系统从“发布”进入了“有客户付费”的阶段。公司的 iWUDI 智能闭环系统是物理 AI 应用落地的典型业务模式，未来该系统有望成为公司业务第二增长曲线，并将反哺公司检测业务，驱动检测业务规模和价值的增长。 **2、请问公司在手订单情况如何？目前在手订单能排到几月份？** 答：从在手订单及客户储备来看，公司与半导体龙头企业客户保持良好合作关系，在手订单充足，主要来自下游客户产线扩建、新产品研发等持续性需求，截止 2026 年 8 月 30 日公司在手订单规模合计约为 2.90 亿元，较上年同期有较大幅度增长，通常可覆盖未来 3-5 个月的收入。

	3、Q3 营收增长仍然很好，但净利润还在下滑，预计什么时候可以看到拐点，对未来有什么展望？ 答：公司 2026 年 1-9 月净利润同比下滑，一方面是公司加大研发投入力度，1-9 月研发费用为 6,390 万元，同比增长 55.78%，公司重点推进在算力芯片、先进封装、高端存储芯片以及人工智能技术方面的技术研发；另一方面公司对核心员工实施股权激励，1-9 月股份支付费用为 1,570 万元，较上年同期增加 1,353 万元；此外，行业竞争加剧导致第二、三代产线业务单价下行，新增设备投入导致折旧及人员培训成本上升，且新设备产能尚未完全释放，也对净利润水平产生影响。 公司 1-9 月扣除股份支付的净利润为 4,651 万元，同比下滑 20.84%；单季度来看，第 3 季度扣除股份支付的净利润为 2,271 万元，环比第 2 季度增长 44.50%，环比改善明显。随着公司五代产线充分发挥在半导体工艺验证、电路验证以及叠层封装芯片系统级故障分析的技术优势，公司在先进逻辑、先进存储、先进封装等领域的业务有望继续增长，净利润水平有望得到改善及提高。 **4、3 季度公司在存储、光通信等方面客户导入的情况？** 答：随着大模型训练与推理算力需求爆发，先进存储芯片堆叠层数与带宽持续提升，公司已与行业龙头企业建立稳定合作，今年前三季度来自先进存储的收入大幅增长。在光电子器件领域，伴随光芯片、光模块等下游市场持续扩容，公司与行业头部客户的合作持续深化，今年前三季度来自光电子器件相关收入较历史年度实现较大幅度增长。 **5、您好，公司四、五代产线的收入贡献情况如何？** 答：公司四、五代产线高度契合半导体前沿技术发展所需要的检测分析需求，四代产线服务于先进制程的电路验证与故障定位，特别在先进制程 SRAM 失效分析展现出独特技术实力，五代产线覆盖 Chiplet、2.5D/3D 先进封装以及系统级封装等多芯片集成方案的检测需求，适配先进封装技术演进下的复杂检测场景。目前公司第四、五代产线收入环比快速增长，覆盖逻辑芯片、存储芯片、光芯片等领域客户，业务拓展情况符合公司预期。未来随着半导体先进制程技术加速迭代、先进封装等技术发展，第四、五代产线有望助力公司加大在高端检测分析市场份额，成为提升公司业绩的重要引擎。 **6、请问公司自研的 ChipMind 大模型和通用大模型什么区别？** 答：公司自研 ChipMind 是面向半导体产业链的垂直物理大模型，其深度融合半导体专业知识，具备先进制程、先进封装等前沿技术场景下的失效分析研判能力，同时 ChipMind 可针对半导体工业场景下的多模态检测数据开展综合分析，而通用大模型较难胜任专业场景的适用。此外 ChipMind 作为公司 iWUDI 智能闭环系统的核心智能中枢，可深度协同工具商城内百余种专业工具，并与案件评估、交期测算、样品跟踪、报告解读等功能模块共同运行，构建从

	客户检测订单提交到报告生成的完整智能闭环，为半导体产业整体提升良率、缩短研发周期等方面提供了系统性解决方案。
风险提示及说明	以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 业绩说明会过程中，公司积极回复投资者提出的问题，回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等制度的规定，回复的信息真实、准确，本次活动不存在应当披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 2 日